

tesa® HAF 8440 HS



Ürün Bilgisi

40 µm yarı saydam HAF montaj bandı

Ürün Açıklaması

Özellikler

- Güvenilir çip modülü yapıştırma
- PVC, ABS ve PC kartlar için uygun
- Tüm yaygın yerleştirme hatlarında iyi işlenebilirlik
- İyi yaşlanma dayanımı
- Monte edilen kartta görünmez

Uygulama Alanları

tesa® HAF 8440, özellikle çip modüllerinin akıllı kartlara gömülmesi için tasarlanmıştır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	yok	• Koruyucu türü	glasin
• Yapışkan türü	copolyamide	• Toplam kalınlık	40 µm

Özellikler / Performans Değerleri

- Bonding strength (push-out) 7 N/mm²

Ek Bilgiler

Teknik Öneriler:

Aşağıdaki değerler, makine parametreleri için başlangıçta önerilen tavsiyelerdir. Lütfen en uygun parametrelerin makine tipine, kart gövdesi ve çip modülleri için kullanılan özel malzemelere ve müşteri gereksinimlerine güçlü şekilde bağlı olduğunu unutmayınız.

1. Ön Laminasyon:

Ön laminasyon sırasında yapıştırıcı bant modül şeridine lamine edilir. Bu adım hat içi veya hat dışı olarak gerçekleştirilebilir. Ön laminasyon adımı, yapıştırıcı bandın raf ömrünü etkilemez.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=8440>

tesa® HAF 8440 HS

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Makine ayarı:

- Sıcaklık: 130-140 °C
- Basınç: 2-3 bar
- Süre: 2,5 m/dak

2. Modül Gömme:

Modül gömme sırasında, ön lamine edilmiş modüller modül şeridinden kesilir, kart oyuntusuna yerleştirilir ve ısı ile basınç uygulanarak kalıcı olarak kart gövdesine yapıştırılır. Bu adımda, tam işleme kullanılan implantasyon hattı tipine bağlıdır. Tek adımlı ve çok adımlı işlemler uygulanabilir. Günümüzde çok adımlı işlem yaygındır:

Tek adımlı işlem - Makine ayarı :

- Sıcaklık¹: 180–220 °C
- Basınç: 65-75 N/modül
- Süre: 1,5 s

Çok adımlı işlem (2 veya daha fazla ısıtma kalıbı) - Makine ayarı:

- Sıcaklık¹: 180–220 °C
- Basınç: 65-75 N/modül
- Süre: 2 x 0,7 s. /3 x 0,5 s

¹ Sıcaklık, ısıtma kalıbı içinde ölçülmüştür. Farklı kart malzemeleri için farklı sıcaklık ayarları önerilir:

*PVC: 180-190 °C

*ABS: 180-190 °C

*PC: 200-220°C

Çip modülü yerleştirme haricindeki uygulamalar için farklı makine parametreleri kullanılmalıdır.

Bağlama mukavemeti değerleri standart laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Değer, her üretim partisinde sağlanan temizlik sınırı ile garanti edilmektedir (Malzeme: Asitlenmiş alüminyum test numunesi / Bağlama koşulları: sıcaklık = 120 °C; basınç = 10 bar; süre = 8 dakika)

tesa® HAF 8440 HS

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

tesa® HAF raf ömrü konseptine göre saklama koşulları.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=8440>